

# 希荻微电子集团股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

### 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2024 年度行动方案”）并已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露。公司现对 2024 年度行动方案的实施情况进行全面评估，同时，在此基础上制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

#### 一、 专注公司主业，持续提升核心竞争力

##### （一） 持续扩充产品料号以满足下游应用多样化需求

2024 年，公司聚焦下游应用场景，推出了多款新产品，为客户提供了更卓越的完整解决方案，主要推出的新产品情况如下表所示：

序号	产品线	产品型号	应用领域
1	锂电池充电系列	如开关充电芯片 HL7009A、开关电容充电芯片 HL7137 等	智能手机、平板电脑、移动物联网设备
2	车载电源系列	如车载 LDO 稳压芯片 HL8743、车载高边开关芯片 HL8518 和 HL8545、HL8545G 等	服务器、汽车电子
3	端口保护系列	如音频和数据开关芯片 HL5281、USB 端口保护和负载开关芯片 HL5075 和 HL5098、GPIO 扩展器芯片 HL5310 等	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、移动物联网设备
4	高性能 DC/DC 系列	如升压稳压芯片 HL7603、HL7613 等	智能手机、平板电脑
5	马达驱动系列	如智能功率模块芯片 HL9901 和 HL9904、马达预驱芯片 HL9611 等	工业、家电
6	电源开关系列	如 e-Fuses 和 Hot Swap 芯片 HL8520E 等	服务器、热插拔系统、笔记本电脑、磁盘驱动器

其中,新产品 HL7603 为市场上首款专为硅负极锂电池设计的 DC/DC 芯片,可大幅提高电池的电量输出和提高电池续航能力,为 AI 手机高效运转保驾护航。公司产品 HL7603 在市场上脱颖而出,抢占了宝贵的商业机会。

2024 年 1 月,公司电荷泵充电芯片 HL7139 以及降压转换芯片 HL7593 更被评选为“2023 年广东省名优高新技术产品”;2024 年 8 月,通过对公司在业内的影响力、认可度、产品品类等标准进行评选,公司荣获 Elexcon 2024 深圳国际电子展和电子发烧友网颁发的“2024 年度领军企业奖”。此外,公司亦荣获了传音控股(股票代码:688036)颁发的“2024 优秀供应商”、vivo 颁发的“2024 年最佳交付奖”、重庆市天实精工科技有限公司颁发的“2024 年度优秀供应商”等诸多荣誉,充分展现了外界对公司研发实力、产品质量与市场前景的高度认可。

## (二) 内生与外延发展并重,巩固和拓展市场份额

2024 年,公司始终聚焦主业,持续用高性能、高可靠、低功耗的芯片解决方案,精准、快速地响应各领域客户的需求,持续加强全球业务拓展及品牌影响力。2024 年,公司实现营业收入 54,551.06 万元,较上年同期增长 38.58%;公司所有产品线总出货金额为人民币 99,991.67 万元,较上年同期增长 60.99%,其中公司音圈马达驱动芯片产品线出货金额为 54,192.25 万元,是公司出货金额主要增长点之一。

2023 年以来,公司通过与韩国上市公司 Dongwoon Anatech Co., Ltd.的合作迅速开拓了音圈马达驱动芯片产品线,即智能视觉感知业务,其中包括开环式自动对焦芯片(包括传统音圈电机驱动芯片和双向音圈电机驱动芯片)、闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片(包括 eOIS 芯片、SMA OIS 芯片、Folded&C-Zoom OIS 芯片)等系列产品。目前,公司的音圈马达驱动芯片产品已成为大中华区品牌手机客户的主流选择,市场占有率水平较高。2024 年第四季度开始,公司音圈马达驱动芯片产品线部分产品已由贸易模式转换为自主委外生产模式。2024 年全年,该产品线为公司贡献主营业务收入 9,267.00 万元,出货金额为 54,192.25 万元。

2025 年,公司将继续积极推进智能视觉感知业务的自产工作,进一步增加自产产品的数量,逐步提升公司营收规模和盈利能力。

2024年8月，公司通过二级全资子公司收购了 Zinitix Co., Ltd.（以下简称“Zinitix”）控股权（以下简称“本次交易”），Zinitix 成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围。交割后，Zinitix 对公司贡献了 8,495.53 万元的营业收入，占比为 15.57%。2025 年，公司将加强双方在产品、供应链与销售渠道等方面的整合，努力发挥协同效应。

2024年11月，公司发布了以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）相关公告，截至目前，本次重大资产重组已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过和中国证监会注册通过，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次重大资产重组的进展情况。

### （三）全方位优化内部管理努力实现“降本增效”

公司把“降本增效”作为 2024 年度经营的重要任务之一，在 2024 年取得的成果如下：

1. 公司积极响应“国产替代”政策，导入新的国内晶圆和封测供应商，通过合理安排委外生产计划，有效调配供应商资源，以降低委外生产成本。同时，公司依托 ERP 系统等数字化工具，持续优化供应链管理，并与核心供应商建立战略合作保障供应链安全。

2. 针对非生产性采购，公司加强供应商管理和建立长期且稳固的合作伙伴关系，通过集中采购策略和框架协议合作，实现成本大幅度降低；同时，通过精细化的风险管理，有效预防采购过程中的潜在风险，保障公司资金的安全和采购供应的稳定性。

3. 公司加强财务管理，通过把降本目标拆解至各部门，精细控制各项费用支出，提升经营效率。

2025 年，公司将立足开源节流核心策略，深化精细化管理体系，严格实施费用审批与预算监管机制；科学合理地制订排产计划和销售计划，一方面通过合理排产提高产能利用率，另一方面对全年销售情况进行合理估计，进一步减少生产过程中可能出现的不必要的费用支出，从而控制成本费用；同时加速推进运营流程精简改造与智能系统深度赋能，全面提升人效指标，推动公司资源向战略板

块倾斜，构建系统性降本增效实施路径。

#### **（四）研发战略优化升级加速公司创新成果转化**

2024年，公司的研发费用为25,261.13万元，占公司营业收入的46.31%，持续高水平的研发投入保证了公司技术和产品的先进性，进一步提高了公司的市场竞争力。其中，公司通过扩充专业技术梯队，实现研发实力的稳步提升，截至2024年12月31日，公司共有研发人员212人（含Zinitix的研发人员），占员工总数量的61.45%。公司始终坚持以市场需求为导向，通过优化组织架构，将研发部嵌入各个业务单元，确保研发团队能够快速接收客户反馈，紧跟商业趋势，灵活调整研发策略，从而精准化产品定义，抢占市场先机。

公司高质量的知识产权布局稳步推进。截至2024年12月31日，公司累计取得国内外专利240项（含Zinitix的149项），均为发明专利，另有集成电路布图设计专有权12项。其中，2024年获得新增授权专利22项，新增集成电路布图设计专有权8项。

另外，公司在2024年获得了一系列的资质认证，包括ISO 26262:2018汽车功能安全ASIL D流程认证证书、再次通过国家高新技术企业认定、被认定为国家级专精特新“小巨人”企业等。这一系列的资质认证是对公司技术水平、创新能力、产品服务等方面的充分认可，也是公司综合实力的体现，有助于公司进一步夯实未来发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。

#### **（五）稳健的人才政策打造多元化、高效能的人才队伍**

公司通过校招、社招、以优秀吸引优秀的内推等方式持续拓宽人才引进渠道，丰富公司人才储备。截至2024年12月31日，公司共有员工345人（含Zinitix的78名员工），稳健的人才政策初见成效。

2024年，公司继续实施常态化股权激励，建立激励与约束机制，以保持科研和业务团队的稳定。2024年3月，公司实施了新一期股权激励计划——2024年股票期权激励计划，分别以14.38元/份、10.66元/份的行权价格向149名激励对象授予共计1,098.25万份股票期权，具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年7月27日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告

编号：2024-035)、《希荻微电子集团股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号：2024-060)。

2025 年，公司将持续优化人才引进与培养机制，重点引进研发技术、销售及综合管理领域专业人才，同步完善绩效考核与激励体系，并通过构建涵盖专业技能培训、管理能力提升的多层次培训体系，全面提升员工队伍的专业素质、创新实践能力、现代化管理水平和科学决策效能。

## 二、 优化财务管理水平，提升经营效率与效果

### (一) 健全公司资金管理体系，提高资金使用效率

2024 年，公司贯彻执行全面预算管理制度，通过预算的执行和监控，有效地控制成本，实现资源的优化配置，公司期间费用占营业收入同比降低 15.36 个百分点。同时，公司强化业财融合，共同推动落实应收账款分析、管理及改善。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投入主要情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目	16,715.66	20,617.79	16,993.13
2	新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	8,531.56	8,531.56	6,619.35
3	总部基地及前沿技术研发项目	23,921.79	20,019.66	3,683.51
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>58,169.01</b>	<b>58,169.01</b>	<b>36,296.00</b>
1	永久补充流动资金	不适用	19,000.00	18,903.71
2	回购公司股份	不适用	4,220.22	4,220.22
3	其他超募资金	不适用	40,751.63	-
<b>超募资金小计</b>		<b>不适用</b>	<b>63,971.84</b>	<b>23,123.93</b>
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>122,140.85</b>	<b>59,419.93</b>

2025年，公司将严格按照相关规定审慎使用募集资金，积极有序推进上述募投项目进行项目建设，力争早日全面投入使用，以满足客户对产品多样化和产品性能提出的更高要求。

## （二）优化存货管理策略，提高存货周转效率

2024年，公司通过以下措施进行存货管理：一是优化存货管理，精准分析销售数据以提升预测准确性，合理控制库存水平；二是深化与晶圆厂、封装厂合作，完善生产运营与质量管理体系，强化供应链协同；三是建立产能与库存的动态平衡机制，设定存货周转率考核目标，通过定期监控分析提升运营效率。通过以上措施的管控，截至2024年12月31日，公司存货净额为13,873.79万元，较上年年末减少32.14%。

## 三、完善公司治理，走高质量发展之路

### （一）完善公司治理制度，促进公司规范运作

2024年上半年，公司根据实际情况，修订了《证券投资与金融衍生品交易管理制度》，新修订的《证券投资与金融衍生品交易管理制度》已于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露。2024年4月，公司组织相关人员参加由广东上市公司协会主办的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）专题培训活动，以更好地理解新《公司法》的核心要义，在优化公司治理、规范投融资行为、股东权利保护等方面全面适应新的法律环境。

2025年，公司将根据新《公司法》及证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，在过渡期内完成公司内部监督机构的调整，并相应修订、完善《公司章程》及相关制度。

此外，2025年，公司将通过以下举措强化对子公司（含海外）管理：一是完善治理架构，委派董事及关键岗位人员，实施统一战略目标与绩效考核体系；二是建立财务垂直管理机制，通过资金集中管控、定期审计及预算审批确保合规运营；三是强化合规与内控，遵循境内外监管要求，动态监测汇率、税务及市场风险；四是推进数字化协同平台应用，实时共享运营数据，优化资源配置；五是实施本地化与全球化结合策略，针对海外子公司制定跨文化管理方案，定期开展合规培训与人才轮岗，平衡业务自主性与集团管控效能。

## （二）强化“关键少数”责任，提高其合规履职能力

2024年，公司积极组织实际控制人以及董监高等“关键少数”参加由证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管单位举办的各类培训共计11场，培训内容涵盖并购重组实务、上市公司独立董事制度改革解读、上市公司规范治理以及新《公司法》修订要点等方面。通过一系列培训，使“关键少数”更加准确地理解最新的监管理念和规则要求，提高其履职能力。

2025年公司将强化“关键少数”履职保障：专人实时响应其关于经营与监管的咨询，推动建议转化为管理实效；规范权责并定期核查大股东及董监高持股，防范权利滥用以保护中小股东权益；通过法规解读、案例培训等方式高效传达监管要求，持续提升其合规履职能力。

## 四、加强投资者沟通，传递公司价值

2024年，公司切实履行信息披露义务，披露了4份定期公告和96份临时公告，公告类型包括募集资金使用与管理、回购股份、股权激励、股东大会、股东减持股份等方面，通过高质量和高透明度的信息披露工作，从而加深投资者对公司的了解，为其提供准确的投资决策依据，切实保护广大投资者的合法权益。

2024年5月13日，公司参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，针对公司2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。2024年，公司通过上海证券交易所“e互动”平台回复投资者问题共计30条，回复率为100%；开展投资者活动共计9场；通过电话热线接听投资者咨询106条。公司通过多样化的渠道，持续与投资者保持良性互动，增强了投资者对公司的参与度和认同感。2025年，公司将通过官网、微信公众号、股吧等平台多维度呈现公司成长性与核心价值，系统阐述竞争壁垒，帮助投资者深度把握行业动向及战略规划，并运用可视化新媒体手段动态披露经营成果，增强投资者参与度和认知度。同时，公司将制定年度投资者沟通计划，通过官网、业绩说明会、上证e互动、IR邮箱、投资者热线等多元渠道，快速响应投资者诉求，保持投资者粘性。

2024年4月27日，公司在上海证券交易所网站披露了中英文版本的2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，向海内外投资者展示公司在可持续发

展和履行社会责任方面的实践，以助力加强与国际投资者建立更加紧密的联系。2024年12月，公司荣获中国证券报、国新咨询有限责任公司颁发的“第二届国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”。根据Wind的数据显示，截至目前，公司的ESG评级为BB。2025年，公司将继续推进和优化ESG建设，推动公司可持续发展，并定期披露环境、社会与公司治理（ESG）报告。

## **五、 共享发展成果，注重投资者回报**

### **（一） 实施回购，提振市场信心**

2024年1月24日，公司将回购证券专用账户中的811,000股已回购股份予以注销。本次股份注销有利于增厚每股收益，进一步提振投资者信心，切实提高股东的投资回报。

2024年5月20日，公司完成第二次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,184,196股，支付的资金总额为人民币27,194,546.85元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-049）。

2025年，公司将继续践行“以投资者为本”的理念，持续关注并监控公司股价走势，根据市场情况和公司财务状况，审慎决策，适时开展股份回购以稳定股价，保障投资者的利益。

### **（二） 完善投资者回报机制**

2024年9月，公司重新审阅了股东回报规划，制定并披露了《希荻微电子集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。后续公司将严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

## **六、 其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

（以下无正文）

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025年4月22日